

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

### 華虹半導體有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代號：01347)

### 新聞稿

## 二零二四年第三季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2024年11月7日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：01347；上交所科創板證券代碼：688347）（“本公司”）於今日公佈截至二零二四年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

#### 二零二四年第三季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入 5.263 億美元，同比下降 7.4%，環比增長 10.0%。
- 毛利率 12.2%，同比下降 3.9 個百分點，環比上升 1.7 個百分點。
- 母公司擁有人應占溢利 4,480 萬美元，同比上升 222.6%，環比上升 571.6%。
- 基本每股盈利 0.026 美元，同比上升 188.9%，環比上升 550.0%。
- 淨資產收益率（年化）2.8%，同比上升 1.6 個百分點，環比上升 2.4 個百分點。

#### 二零二四年第四季度指引

- 我們預計銷售收入約在 5.3 億美元至 5.4 億美元之間。
- 我們預計毛利率約在 11%至 13%之間。

## 總裁致辭

公司總裁兼執行董事唐均君先生對 2024 年第三季度業績評論道：

“半導體市場的整體復蘇態勢比較符合我們的預期，但存在著結構性的分化。消費電子及部分新興應用等領域的需求向好，功率半導體等需求情況的改善仍有待觀察。2024 年第三季度，華虹半導體的銷售收入達到 5.263 億美元、毛利率為 12.2%，均優於指引，並均實現了環比提升。產能利用率也達到了全方位滿產。多元化的產品結構及營運效率的優化，展現出公司在面對複雜市場環境時擁有較好的韌性。”

唐總繼續表示：“無錫新 12 英寸產線的建設持續按計劃推進，預計各工藝平臺的試生產及工藝驗證將在今年年底到明年年初全面鋪開。我們將利用新生產線進行工藝平臺的持續技術迭代，以滿足下游各類新興需求的不斷湧現與增長，帶動公司整體營運表現邁上新臺階。”

## 電話會議公告

日期 2024 年 11 月 7 日，星期四

時間： 17:00 香港/上海時間

04:00 美國東部時間

發言人： 唐均君，總裁兼執行董事  
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 會議將在 [https://www.huahonggrace.com/c/ir\\_calendar.php](https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php) 或

<https://edge.media-server.com/mmc/p/c3dkanq> 作線上直播

(請提前註冊登記)

電話直撥： 請在會議前使用以下鏈接先進行註冊。註冊後，您將收到確認郵件獲得撥入號碼及 PIN (個人身份識別碼)。

<https://register.vevent.com/register/BI64f699022e5246a4952424f5bd0c3548>

**重要提示：**在會議開始前，您需要使用確認郵件中提供的 PIN (個人身份識別碼) 才能進入會議。請在註冊後，注意查收並保存確認郵件。出於安全原因，請不要與任何人共享您的 PIN (個人身份識別碼)。

網上重播： 直播約 2 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。

[https://www.huahonggrace.com/c/ir\\_calendar.php](https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php)

## 關於華虹半導體

華虹半導體有限公司 (A 股簡稱: 華虹公司, 688347; 港股簡稱: 華虹半導體, 01347) (“本公司”) 是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業, 秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先進“特色 IC + Power Discrete”的發展戰略, 為客戶提供多元化的晶圓代工及配套服務。本公司專注於嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯與射頻等“8 英寸 + 12 英寸”特色工藝技術的持續創新, 有力支持新能源汽車、綠色能源、物聯網等新興領域應用, 其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員, 而華虹集團是中國擁有“8 英寸 + 12 英寸”先進集成電路製造主流工藝技術的產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠, 月產能約 18 萬片。另在無錫高新技術產業開發區內建有一座月產能 9.45 萬片的 12 英寸晶圓廠 (“華虹無錫”), 這不僅是全球領先的 12 英寸特色工藝生產線, 也是全球第一條 12 英寸功率器件代工生產線。目前, 本公司正在推進華虹無錫二期 12 英寸芯片生產線 (“華虹製造”) 的建設。

如欲取得更多公司相關資料, 請瀏覽: [www.huahonggrace.com](http://www.huahonggrace.com)。

**經營業績概要**  
(以仟美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二四年 第三季度 (未經審核)	二零二三年 第三季度 (未經審核)	二零二四年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	526,306	568,529	478,524	(7.4)%	10.0 %
<b>毛利</b>	<b>64,007</b>	<b>91,623</b>	<b>50,063</b>	<b>(30.1)%</b>	<b>27.9 %</b>
<b>毛利率</b>	<b>12.2 %</b>	<b>16.1 %</b>	<b>10.5 %</b>	<b>(3.9)</b>	<b>1.7</b>
經營開支	(81,430)	(85,065)	(90,328)	(4.3)%	(9.9)%
其他收入/(損失)淨額	51,797	(19,417)	6,885	(366.8)%	652.3 %
<b>稅前溢利/(損失)</b>	<b>34,374</b>	<b>(12,859)</b>	<b>(33,380)</b>	<b>(367.3)%</b>	<b>(203.0)%</b>
所得稅開支	(11,461)	(12,999)	(8,368)	(11.8)%	37.0 %
<b>期內溢利/(損失)</b>	<b>22,913</b>	<b>(25,858)</b>	<b>(41,748)</b>	<b>(188.6)%</b>	<b>(154.9)%</b>
<b>淨利潤率</b>	<b>4.4 %</b>	<b>(4.5)%</b>	<b>(8.7)%</b>	<b>8.9</b>	<b>13.1</b>
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	44,816	13,890	6,673	222.6 %	571.6 %
非控股權益	(21,903)	(39,748)	(48,421)	(44.9)%	(54.8)%
持有人應佔每股盈利					
基本	0.026	0.009	0.004	188.9 %	550.0 %
攤薄	0.026	0.009	0.004	188.9 %	550.0 %
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	1,200	1,077	1,106	11.4 %	8.5 %
產能利用率 <sup>1</sup>	105.3 %	86.8 %	97.9 %	18.5	7.4
淨資產收益率 <sup>2</sup>	2.8 %	1.2 %	0.4 %	1.6	2.4

**二零二四年第三季度**

- 銷售收入 5.263 億美元，同比下降 7.4%，主要由於平均銷售價格下降，部分被付運晶圓數量上升所抵消，環比增長 10.0%，主要由於付運晶圓數量上升。
- 毛利率 12.2%，同比下降 3.9 個百分點，主要由於平均銷售價格下降，部分被產能利用率提升所抵消，環比上升 1.7 個百分點，主要由於產能利用率提升。
- 經營開支 8,140 萬美元，同比和環比分別下降 4.3%和 9.9%，主要由於研發工程片開支下降。
- 其他收入淨額 5,180 萬美元，上年同期為其他損失淨額 1,940 萬美元，上季度為其他收入淨額 690 萬美元，主要由於本季度為外幣匯兌收益，而上年同期及上季度為外幣匯兌損失，以及本季度政府補貼上升。
- 所得稅開支 1,150 萬美元，同比下降 11.8%，環比上升 37.0%。
- 期內溢利 2,290 萬美元，上年同期為期內損失 2,590 萬美元，上季度為期內損失 4,170 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 4,480 萬美元，同比上升 222.6%，環比上升 571.6%。
- 基本每股盈利 0.026 美元，同比上升 188.9%，環比上升 550.0%。
- 淨資產收益率（年化）2.8%，同比上升 1.6 個百分點，環比上升 2.4 個百分點。

<sup>1</sup>產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

<sup>2</sup>母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

#### 銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二四年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第三季度 % (未經審核)	二零二三年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	497,847	94.6 %	538,547	94.7 %	(40,700)	(7.6)%
其他	28,459	5.4 %	29,982	5.3 %	(1,523)	(5.1)%
<b>銷售收入總額</b>	<b>526,306</b>	<b>100.0 %</b>	<b>568,529</b>	<b>100.0 %</b>	<b>(42,223)</b>	<b>(7.4)%</b>

- 本季度 94.6%的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

#### 銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二四年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第三季度 % (未經審核)	二零二三年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	263,139	50.0 %	298,615	52.5 %	(35,476)	(11.9)%
12 吋晶圓	263,167	50.0 %	269,914	47.5 %	(6,747)	(2.5)%
<b>銷售收入總額</b>	<b>526,306</b>	<b>100.0 %</b>	<b>568,529</b>	<b>100.0 %</b>	<b>(42,223)</b>	<b>(7.4)%</b>

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入各貢獻了銷售收入總額的 50%。

### 銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二四年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第三季度 % (未經審核)	二零二三年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 <sup>3</sup>	434,532	82.5 %	441,246	77.5 %	(6,714)	(1.5)%
北美 <sup>4</sup>	46,709	8.9 %	48,764	8.6 %	(2,055)	(4.2)%
亞洲 <sup>5</sup>	27,829	5.3 %	34,663	6.1 %	(6,834)	(19.7)%
歐洲	16,358	3.1 %	38,976	6.9 %	(22,618)	(58.0)%
日本 <sup>6</sup>	878	0.2 %	4,880	0.9 %	(4,002)	(82.0)%
<b>銷售收入總額</b>	<b>526,306</b>	<b>100.0 %</b>	<b>568,529</b>	<b>100.0 %</b>	<b>(42,223)</b>	<b>(7.4)%</b>

- 本季度來自於中國的銷售收入 4.345 億美元，占銷售收入總額的 82.5%，同比下降 1.5%，主要由於 IGBT、超級結和閃存產品的需求及平均銷售價格下降，部分被 CIS 及其他電源管理的產品需求增加所抵消。
- 本季度來自於北美的銷售收入 4,670 萬美元，同比下降 4.2%，主要由於 MCU、通用 MOSFET、邏輯、及超級結產品的需求下降，部分被其他電源管理產品的需求增加所抵消。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 2,780 萬美元，同比下降 19.7%，主要由於邏輯、超級結及通用 MOSFET 產品的需求下降。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 1,640 萬美元，同比下降 58.0%，主要由於智能卡芯片、IGBT 及通用 MOSFET 產品的需求下降。
- 本季度來自於日本的銷售收入 90 萬美元，同比下降 82.0%，主要由於超級結、MCU 及邏輯產品的需求下降。

<sup>3</sup>包括中國大陸及中國香港。

<sup>4</sup>包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

<sup>5</sup>不包括中國及日本。

<sup>6</sup>包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

### 銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二四年	二零二四年	二零二三年	二零二三年	同比	同比
	第三季度	第三季度	第三季度	第三季度		
	仟美元	%	仟美元	%	仟美元	%
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)		
嵌入式非易失性存儲器	132,598	25.2 %	143,629	25.3 %	(11,031)	(7.7)%
獨立式非易失性存儲器	29,334	5.6 %	36,800	6.5 %	(7,466)	(20.3)%
分立器件	163,253	31.1 %	235,978	41.5 %	(72,725)	(30.8)%
邏輯及射頻	77,010	14.6 %	49,878	8.8 %	27,132	54.4 %
模擬與電源管理	122,850	23.3 %	100,897	17.7 %	21,953	21.8 %
其他	1,261	0.2 %	1,347	0.2 %	(86)	(6.4)%
<b>銷售收入總額</b>	<b>526,306</b>	<b>100.0 %</b>	<b>568,529</b>	<b>100.0 %</b>	<b>(42,223)</b>	<b>(7.4)%</b>

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 1.326 億美元，同比下降 7.7%，主要由於智能卡芯片的需求下降。
- 本季度獨立式非易失性存儲器銷售收入 2,930 萬美元，同比下降 20.3%，主要由於閃存產品的平均銷售價格及需求下降。
- 本季度分立器件銷售收入 1.633 億美元，同比下降 30.8%，主要由於 IGBT 及超級結產品的平均銷售價格及需求下降。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 7,700 萬美元，同比增長 54.4%，主要得益於 CIS 及邏輯產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 1.229 億美元，同比增長 21.8%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。

### 銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的 銷售收入	二零二四年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第三季度 % (未經審核)	二零二三年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
55nm 及 65nm	116,596	22.2 %	87,329	15.4 %	29,267	33.5 %
90nm 及 95nm	98,966	18.8 %	87,616	15.4 %	11,350	13.0 %
0.11 $\mu$ m 及 0.13 $\mu$ m	68,274	13.0 %	82,990	14.6 %	(14,716)	(17.7)%
0.15 $\mu$ m 及 0.18 $\mu$ m	37,894	7.2 %	34,993	6.2 %	2,901	8.3 %
0.25 $\mu$ m	4,155	0.8 %	8,395	1.5 %	(4,240)	(50.5)%
0.35 $\mu$ m 及以上	200,421	38.0 %	267,206	46.9 %	(66,785)	(25.0)%
<b>銷售收入總額</b>	<b>526,306</b>	<b>100.0 %</b>	<b>568,529</b>	<b>100.0 %</b>	<b>(42,223)</b>	<b>(7.4)%</b>

- 本季度 55nm 及 65nm 工藝技術節點的銷售收入 1.166 億美元，同比增長 33.5%，主要得益於 CIS 及其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 9,900 萬美元，同比增長 13.0%，主要得益於 MCU 及其他電源管理產品的需求增加，部分被智能卡芯片的需求下降所抵消。
- 本季度 0.11 $\mu$ m 及 0.13 $\mu$ m 工藝技術節點的銷售收入 6,830 萬美元，同比下降 17.7%，主要由於 MCU 產品的平均銷售價格及智能卡芯片的需求下降。
- 本季度 0.15 $\mu$ m 及 0.18 $\mu$ m 工藝技術節點的銷售收入 3,790 萬美元，同比增長 8.3%，主要得益於邏輯及其他電源管理產品的需求增加，部分被模擬產品的需求下降所抵消。
- 本季度 0.25 $\mu$ m 工藝技術節點的銷售收入 420 萬美元，同比下降 50.5%，主要由於 RF 產品的需求下降。
- 本季度 0.35 $\mu$ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 2.004 億美元，同比下降 25.0%，主要由於 IGBT 及超級結產品的需求及平均銷售價格下降。



### 銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的 銷售收入	二零二四年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第三季度 % (未經審核)	二零二三年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零二三年 第三季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
電子消費品	330,928	62.9 %	325,224	57.2 %	5,704	1.8 %
工業及汽車	123,853	23.5 %	159,380	28.0 %	(35,527)	(22.3)%
通訊	65,952	12.5 %	71,662	12.6 %	(5,710)	(8.0)%
計算機	5,573	1.1 %	12,263	2.2 %	(6,690)	(54.6)%
<b>銷售收入總額</b>	<b>526,306</b>	<b>100.0 %</b>	<b>568,529</b>	<b>100.0 %</b>	<b>(42,223)</b>	<b>(7.4)%</b>

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 3.309 億美元，占銷售收入總額的 62.9%，同比增長 1.8%，主要得益於其他電源管理的需求增加，部分被超級結和閃存產品的平均銷售價格及需求下降所抵消。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 1.239 億美元，同比下降 22.3%，主要由於 IGBT 產品的平均銷售價格及需求下降，部分被其他電源管理產品的需求增加所抵消。
- 本季度通訊產品銷售收入 6,600 萬美元，同比下降 8.0%，主要由於智能卡芯片及模擬產品的需求下降，部分被 CIS 產品需求增加所抵消。
- 本季度計算機產品銷售收入 560 萬美元，同比下降 54.6%，主要由於通用 MOSFET 及超級結產品的需求下降。

### 產能<sup>7</sup>及產能利用率

晶圓廠(折合仟片晶圓)	二零二四年 第三季度 (未經審核)	二零二三年 第三季度 (未經審核)	二零二四年 第二季度 (未經審核)
產能 (200mm)	178	178	178
產能 (300mm)	95	80	95
<b>合計產能(折合 8 吋仟片晶圓)</b>	<b>391</b>	<b>358</b>	<b>391</b>
產能利用率 (200mm)	113.0%	95.3%	107.6%
產能利用率 (300mm)	98.5%	78.4%	89.3%
總體產能利用率	105.3%	86.8%	97.9%

- 本季度末月產能 391,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 105.3%，較上季度上升 7.4 個百分點。

<sup>7</sup> 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

### 付運晶圓

折合 8 吋矽片晶圓	二零二四年 第三季度 (未經審核)	二零二三年 第三季度 (未經審核)	二零二四年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	1,200	1,077	1,106	11.4 %	8.5 %

- 本季度付運晶圓 1,200,000 片，同比上升 11.4%，環比上升 8.5%。

### 經營開支分析

以仟美元計	二零二四年 第三季度 (未經審核)	二零二三年 第三季度 (未經審核)	二零二四年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,241	2,415	2,785	(7.2)%	(19.5)%
管理費用 <sup>8</sup>	79,189	82,650	87,543	(4.2)%	(9.5)%
<b>經營開支</b>	<b>81,430</b>	<b>85,065</b>	<b>90,328</b>	<b>(4.3)%</b>	<b>(9.9)%</b>

- 經營開支 8,140 萬美元，同比和環比分別下降 4.3%和 9.9%，主要由於研發工程片開支下降。

### 其他收入/(損失)淨額

以仟美元計	二零二四年 第三季度 (未經審核)	二零二三年 第三季度 (未經審核)	二零二四年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,612	3,428	3,558	5.4 %	1.5 %
利息收入	26,710	15,742	29,787	69.7 %	(10.3)%
匯兌收益/(損失)	29,270	(13,986)	(7,921)	(309.3)%	(469.5)%
分佔聯營公司溢利/(損失)	1,087	(1,410)	1,394	(177.1)%	(22.0)%
財務費用	(27,275)	(24,257)	(24,847)	12.4 %	9.8 %
政府補貼	18,535	77	4,778	23,971.4 %	287.9 %
其他	(142)	989	136	(114.4)%	(204.4)%
<b>其他收入/(損失)淨額</b>	<b>51,797</b>	<b>(19,417)</b>	<b>6,885</b>	<b>(366.8)%</b>	<b>652.3 %</b>

- 其他收入淨額 5,180 萬美元，上年同期為其他損失淨額 1,940 萬美元，上季度為其他收入淨額 690 萬美元，主要由於本季度為外幣匯兌收益，而上年同期及上季度為外幣匯兌損失，以及本季度政府補貼上升。

<sup>8</sup>管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

### 現金流量分析

以仟美元計	二零二四年 第三季度 (未經審核)	二零二三年 第三季度 (未經審核)	二零二四年 第二季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所(用)/得現金流量淨額	(26,838)	152,091	96,890	(117.6)%	(127.7)%
投資活動所用現金流量淨額	(715,920)	(177,466)	(171,973)	303.4 %	316.3 %
融資活動所(用)/得現金流量淨額	(5,007)	3,176,383	416,148	(100.2)%	(101.2)%
外匯匯率變動影響淨額	90,648	(12,464)	(25,185)	(827.3)%	(459.9)%
<b>現金及現金等價物變動影響淨額</b>	<b>(657,117)</b>	<b>3,138,544</b>	<b>315,880</b>	<b>(120.9)%</b>	<b>(308.0)%</b>

- 本季度經營活動所用現金流量淨額 2,680 萬美元，上年同期及上季度分別為經營活動所得現金流量 1.521 億美元及 9,690 萬美元，主要由於本季度支付的進口增值稅增加，部分被收到政府補貼上升所抵消。
- 投資活動所用現金流量淨額 7.159 億美元，其中包括固定資產投資支出 7.340 億美元，部分被收到利息收入 1,810 萬美元所抵消。
- 融資活動所用現金流量淨額 500 萬美元，其中償還銀行借款本金 450 萬美元，支付利息 330 萬美元，及支付租賃負債 100 萬美元，部分被提取銀行借款 230 萬美元，及員工行權發行股份收到 150 萬美元所抵消。

### 資本結構

以仟美元計	於九月三十日 二零二四年 (未經審核)	於六月三十日 二零二四年 (未經審核)
資產總額	13,082,459	12,104,780
負債總額	3,867,040	3,059,884
所有者權益總額	9,215,419	9,044,896
資產負債率 <sup>9</sup>	29.6%	25.3%

### 資本開支

以仟美元計	二零二四年 第三季度 (未經審核)	二零二四年 第二季度 (未經審核)
華虹 8 吋	28,607	27,997
華虹無錫	87,754	40,431
華虹製造	617,708	128,402
<b>合計</b>	<b>734,069</b>	<b>196,830</b>

- 本季度資本開支 7.340 億美元，其中 6.177 億美元用於華虹製造，8,780 萬美元用於華虹無錫，及 2,860 萬美元用於華虹 8 吋。

<sup>9</sup>資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以仟美元計	於九月三十日 二零二四年 (未經審核)	於六月三十日 二零二四年 (未經審核)
發展中物業	225,711	207,151
存貨	487,480	462,563
貿易應收款項及應收票據	268,186	274,382
預付款項、其他應收款項及其他資產	269,191	75,761
應收關聯方款項	25,426	16,034
已凍結存款及定期存款	32,443	39,259
現金及現金等價物	5,766,749	6,423,866
<b>流動資產總額</b>	<b>7,075,186</b>	<b>7,499,016</b>
貿易應付款項	273,352	246,206
其他應付款項及暫估費用	1,237,992	505,945
計息銀行借款	262,296	247,034
租賃負債	4,451	4,674
政府補助	40,072	39,359
應付關聯方款項	10,167	8,340
應付所得稅	26,494	19,038
<b>流動負債總額</b>	<b>1,854,824</b>	<b>1,070,596</b>
<b>淨營運資金</b>	<b>5,220,362</b>	<b>6,428,420</b>
速動比率	3.4x	6.4x
流動比率	3.8x	7.0x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	47	55
存貨周轉天數	92	94

- 預付款項、其他應收款項及其他資產由上季度末的 7,580 萬美元上升至本季度末的 2.692 億美元，主要由於增值稅留抵稅額增加。
- 應收關聯方款項由上季度末的 1,600 萬美元上升至本季度末的 2,540 萬美元，主要由於應收一家關聯方的租賃款增加。
- 其他應付款項及暫估費用由上季度末的 5.059 億美元上升至本季度末的 12.380 億美元，主要由於應付資本開支增加。
- 應付關聯方款項由上季度末的 830 萬上升至本季度末的 1,020 萬美元，主要由於應付關聯方的貿易款項上升。
- 應付所得稅由上季度末的 1,900 萬美元上升至本季度末的 2,650 萬美元，主要由於本季度計提所得稅開支。
- 淨營運資金 本季度末 52.204 億美元，流動比率 3.8。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數 47 天。
- 存貨周轉天數 92 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 [www.huahonggrace.com](http://www.huahonggrace.com)。

華虹半導體有限公司  
簡明損益表(以仟美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日	於九月三十日	於六月三十日
	二零二四年 (未經審核)	二零二三年 (未經審核)	二零二四年 (未經審核)
銷售收入	526,306	568,529	478,524
銷售成本	(462,299)	(476,906)	(428,461)
<b>毛利</b>	<b>64,007</b>	<b>91,623</b>	<b>50,063</b>
其他收入及收益	78,092	20,290	38,259
銷售及分銷費用	(2,241)	(2,415)	(2,785)
管理費用	(79,189)	(82,650)	(87,543)
其他費用	(107)	(14,040)	(7,921)
財務費用	(27,275)	(24,257)	(24,847)
分佔聯營公司溢利/(損失)	1,087	(1,410)	1,394
<b>稅前溢利/(損失)</b>	<b>34,374</b>	<b>(12,859)</b>	<b>(33,380)</b>
所得稅開支	(11,461)	(12,999)	(8,368)
<b>期內溢利/(損失)</b>	<b>22,913</b>	<b>(25,858)</b>	<b>(41,748)</b>
以下各方應佔利潤			
母公司擁有人	44,816	13,890	6,673
非控股權益	(21,903)	(39,748)	(48,421)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.026	0.009	0.004
攤薄	0.026	0.009	0.004
<b>用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數</b>	<b>1,717,612,830</b>	<b>1,580,159,540</b>	<b>1,716,917,408</b>
<b>用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數</b>	<b>1,721,402,553</b>	<b>1,587,083,357</b>	<b>1,720,532,998</b>

華虹半導體有限公司  
簡明綜合財務狀況表(以仟美元計)

	截至		
	於九月三十日 二零二四年 (未經審核)	於六月三十日 二零二四年 (未經審核)	於九月三十日 二零二三年 (未經審核)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	5,198,989	3,750,176	3,322,946
投資物業	168,433	165,611	164,287
使用權資產	81,372	80,629	79,070
無形資產	38,897	42,320	29,182
於聯營公司的投資	144,534	141,036	128,833
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	290,857	285,938	153,024
長期預付款項	83,396	139,425	36,085
遞延稅項資產	795	629	17,217
<b>非流動資產總額</b>	<b>6,007,273</b>	<b>4,605,764</b>	<b>3,930,644</b>
<b>流動資產</b>			
發展中物業	225,711	207,151	157,230
存貨	487,480	462,563	492,783
貿易應收款項及應收票據	268,186	274,382	318,787
預付款項、其他應收款項及其他資產	269,191	75,761	34,168
應收關聯方款項	25,426	16,034	19,572
已凍結存款及定期存款	32,443	39,259	31,654
現金及現金等價物	5,766,749	6,423,866	4,989,501
<b>流動資產總額</b>	<b>7,075,186</b>	<b>7,499,016</b>	<b>6,043,695</b>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	273,352	246,206	213,530
其他應付款項及暫估費用	1,237,992	505,945	357,181
計息銀行借款	262,296	247,034	180,238
租賃負債	4,451	4,674	3,281
政府補助	40,072	39,359	34,321
應付關聯方款項	10,167	8,340	4,604
應付所得稅	26,494	19,038	57,885
<b>流動負債總額</b>	<b>1,854,824</b>	<b>1,070,596</b>	<b>851,040</b>
<b>流動資產淨額</b>	<b>5,220,362</b>	<b>6,428,420</b>	<b>5,192,655</b>
<b>總資產減流動負債</b>	<b>11,227,635</b>	<b>11,034,184</b>	<b>9,123,299</b>
<b>非流動負債</b>			
計息銀行借款	1,983,494	1,964,956	1,745,779
租賃負債	19,334	19,440	18,650
遞延稅項負債	9,388	4,892	26,625
<b>非流動負債總額</b>	<b>2,012,216</b>	<b>1,989,288</b>	<b>1,791,054</b>
<b>淨資產</b>	<b>9,215,419</b>	<b>9,044,896</b>	<b>7,332,245</b>
<b>權益和負債權益</b>			
股本	4,936,472	4,935,470	4,932,673
儲備	1,478,303	1,333,799	1,164,151
<b>本公司擁有人應佔權益</b>	<b>6,414,775</b>	<b>6,269,269</b>	<b>6,096,824</b>
非控股權益	2,800,644	2,775,627	1,235,421
<b>權益總額</b>	<b>9,215,419</b>	<b>9,044,896</b>	<b>7,332,245</b>

華虹半導體有限公司  
簡明綜合現金流量表(以仟美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於九月三十日	於九月三十日	於六月三十日
	二零二四年 (未經審核)	二零二三年 (未經審核)	二零二四年 (未經審核)
<b>經營活動現金流量：</b>			
稅前溢利/(虧損)	34,374	(12,859)	(33,380)
折舊及攤銷	143,557	127,305	136,881
應佔聯營公司(溢利)/損失	(1,087)	1,410	(1,394)
營運資金的變動及其它	(203,682)	36,235	(5,217)
<b>經營活動所(用)/得現金流量淨額</b>	<b>(26,838)</b>	<b>152,091</b>	<b>96,890</b>
<b>投資活動現金流量：</b>			
購置物業、廠房、設備及無形資產項目	(734,069)	(193,652)	(196,830)
其他投資活動所得現金流量	18,149	16,186	24,857
<b>投資活動所用現金流量淨額</b>	<b>(715,920)</b>	<b>(177,466)</b>	<b>(171,973)</b>
<b>融資活動現金流量：</b>			
非控股權益資本注資	-	-	492,450
提取銀行貸款	2,287	347,707	99,042
發行股份所得收益	1,471	2,937,689	579
償還銀行貸款	(4,476)	(239,086)	(87,530)
已付利息	(3,283)	(3,803)	(49,800)
向股東支付股息	(7,371)	-	(28,876)
已抵押存款減少/(增加)	7,369	136,524	(7,369)
支付租賃負債	(1,004)	(1,230)	(2,348)
其他融資活動所用現金流量	-	(1,418)	-
<b>融資活動所(用)/得現金流量淨額</b>	<b>(5,007)</b>	<b>3,176,383</b>	<b>416,148</b>
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(747,765)	3,151,008	341,065
外匯匯率變動影響淨額	90,648	(12,464)	(25,185)
期初現金及現金等價物	6,423,866	1,850,957	6,107,986
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>5,766,749</b>	<b>4,989,501</b>	<b>6,423,866</b>

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

張素心(董事長)  
唐均君(總裁)

**非執行董事**

葉峻  
孫國棟  
周利民  
熊承艷

**獨立非執行董事**

張祖同  
王桂壠太平紳士  
封松林

**承董事會命**

華虹半導體有限公司  
張素心  
董事長兼執行董事

中國 香港

二零二四年十一月七日